

50W用	ラスター彫刻					ベクター彫刻				
	パワー	スピード	PPI	パス	深さ	パワー	スピード	PPI	パス	深さ
アルマイト処理アルミ	27	80	500	1	0.0254	6	4	1000	1	0.0254
大理石	100	92	500	1	0.0762	12	4	500	1	0.0762
アクリル樹脂(浅い)	20	80	500	1	0.0254	3	5.8	1000	1	0.254
アクリル樹脂(深い)	100	67	500	1	0.254					
アクリル樹脂(切断)						45	0.4	1000	1	5.08
ラバースタンプ	100	27	500	1	0.762	60	2.7	90	1	1.016
コルク	80	100	500	1	0.254	6	4	500	1	0.254
コルク(切断)						30	1.6	100	1	1.524
木材	100	67	500	1	0.508	80	8.3	500	1	0.762
木材(切断)						50	2.7	250	1	3.175
デルリン	100	58	500	1	0.381					
デルリン(切断)						75	4	200	1	1.524
厚紙・マットボード	27	80	250	1	0.127	12	4	250	1	0.127
厚紙・マットボード(切断)						30	3.2	200	1	1.27
人工大理石(浅い)	100	67	500	1	0.127	30	4	1000	1	0.254
人工大理石(深い)	100	33	1000	1	0.381					
ガラス	100	33	300	1	0.0254	10	6.7	300	1	0.0254
メラミン(浅い)	100	67	500	1	0.381	12	4	500	1	0.254
メラミン(深い)	100	47	500	1	0.508					
皮革	17	80	500	1	0.0254	3	4	500	1	0.254
皮革(切断)						50	3.3	200	1	2.54
二層板(RAWMRK)	20	100	500	1	-	50	10	500	3	-

ワンポイント アドバイス

ベクター切断時、完全に切り落とすことも出来ませんが上記の設定は厚みの80%程度の切れ込みを入れるようになっています。これは切断面を状態で保つためです。加工終了後に手で切り離してください。

ベクター切断時に完全に切り落としてしまいたい時は、上記のスピード設定は5~5.5倍にし、パスを10回程度にしてください。これは、1回のパスで切断できる設定にすると切断面が溶けるなどの弊害が起こるためです。但し、切り落とす時は極力ハニカム加工テーブルして材料を浮かした状態で切断してください。これはレーザーの輻射による材料裏面の溶解・汚れを防ぐためです。

ベクター切断時にカット部分の淵が汚れますが、切り離す前に乾いたティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。また、表面が白色のタイプで汚れが落ちにくい場合は、事務用のプラスチック消しゴムで軽くこすってください。

文字の部分を残して周りをラスター加工する場合(広範囲のラスター加工)は熱収縮による材料のソリ(変形)が起こります。極力、文字部分ようにしてください。

レーザーライト (裏面シールタイプ)	ラスター彫刻					ベクター切断(シール台紙は切断しない)				
	パワー	スピード	PPI	パス	深さ	パワー	スピード	PPI	パス	深さ
	18	100	500	1	-	40	40	500	1	-
						ベクター切断(シール台紙も切断する)				
						パワー	スピード	PPI	パス	深さ
						40	40	500	2	-

ワンポイント アドバイス

ベクター切断時にカット部分の淵が汚れますが、切り離す前に乾いたティッシュペーパーなどで軽くふき取ってください。

文字の部分を残して周りをラスター加工する場合(広範囲のラスター加工)は熱収縮による材料のソリ(変形)が起こります。極力、文字部分ようにしてください。